

<<电脑组装和维护入门与提高>>

图书基本信息

书名：<<电脑组装和维护入门与提高>>

13位ISBN编号：9787302283027

10位ISBN编号：7302283028

出版时间：2012-5

出版时间：清华大学出版社

作者：凤舞科技

页数：409

字数：676000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电脑组装和维护入门与提高>>

内容概要

《电脑组装和维护入门与提高(附光盘)》由凤舞科技编著，是一本电脑组装与维护大全，也是一本案头工具宝典。

全书通过4大篇幅内容布局、

5种系统安装详解、10种硬件选购讲解、17章专题技术讲解、80个常见故障、210多个实战技巧放送、250多分钟视频演示、1400多张图片全程图解，帮助读者在最短的时间内具备从入门到提高电脑的选购、使用、组装和维护的能力，从而成为优秀的电脑高手。

《电脑组装和维护入门与提高(附光盘)》分为4篇：电脑选购篇、组装设置篇、检测使用篇、安全维护篇，共17章，具体内容包括：认识电脑，选购电脑硬件设备，组装电脑全程图解，设置与应用BIOS，分区与格式化硬盘，安装电脑操作系统，安装与管理驱动程序，连接与共享网络，检查与测试系统性能，安装、使用与卸载软件，注册表的认识与使用，安装与使用常用外设，操作系统的安全防治，保养电脑与优化系统，备份与还原操作系统，修复与重装操作系统以及诊断与排除电脑故障等。通过理论与实践相结合的方式，帮助读者加深对电脑的理解和应用。

本书结构清晰、语言简洁，是广大初级、中级电脑用户以及家庭电脑用户的首选工具书，适合于电脑使用者阅读，同时对于即将购买组装电脑的用户来说，也是最佳的学习和指导手册。

<<电脑组装和维护入门与提高>>

书籍目录

电脑选购篇

第1章 认识电脑

第2章 选购电脑硬件设备

组装设置篇

第3章 组装电脑全程图解

第4章 设置与应用BIOS

第5章 分区与格式化硬盘

第6章 安装电脑操作系统

第7章 安装与管理驱动程序

第8章 连接与共享网络

检测使用篇

第9章 检查与测试系统性能

第10章 安装、使用与卸载软件

第11章 注册表的认识与使用

第12章 安装与使用常用外设

安全维护篇

第13章 操作系统的安全防治

第14章 保养电脑与优化系统

第15章 备份与还原操作系统

第16章 修复与重装操作系统

第17章 诊断与排除电脑故障

章节摘录

版权页：插图：4.CPU的位和字长 位：在数字电路和电脑技术中采用二进制，代码只有0和1，其中无论是0或是1在CPU中都是一位。

字长：电脑技术中对CPU在单位时间内（同一时间）能一次处理的二进制数的位数叫字长。

所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。

同理32位的CPU能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。

字节和字长的区别：由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示，所以通常就将8位称为一个字节。

字长的长度是不固定的，对于不同的CPU、字长的长度也不一样。

8位的CPU一次只能处理一个字节，而32位的CPU一次能处理4个字节，同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

5.CPU扩展指令集 CPU依靠指令来计算和控制系统，每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。

指令的强弱也是CPU的重要指标，指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。

从现阶段的主流体系结构来讲，指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分，目前使用的CPU多为复杂指令集CPU。

从具体运用上看，Intel的MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSE4系列以及AMD的3DNow！

等都是CPU的扩展指令集，这些指令集增强了CPU对多媒体、图形以及Internet等的处理能力。

通常会把CPU的扩展指令集称为“CPU的指令集”。

SSE3指令集是目前规模最小的指令集，此前MMX包含有57条命令，SSE包含有70条命令，SSE2包含有144条新增命令，SSE3包含有13条新增命令。

目前SSE4是最先进的指令集，英特尔酷睿系列处理器已经支持SSE4指令集。

6.工作电压 工作电压是指CPU正常工作所需的电压，提高CPU工作电压，可以加强CPU内部信号，增强CPU的稳定性能，加快CPU的工作频率，但很容易导致CPU温度过高，降低CPU的使用寿命，甚至烧坏CPU。

从586 CPU开始，CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种，通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。

其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定，一般制作工艺越小，内核工作电压越低；而I/O电压一般都在1.6~5V之间。

近年来，各种CPU的工作电压正在逐步下降，以解决CPU发热过高的问题。

7.制造工艺 制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。

制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。

密度愈高的IC电路设计，意味着在同样大小面积的IC中可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。

现在CPU的制造工艺是0.35微米，PII和赛扬可以达到0.25微米，最新的CPU制造工艺可以达到0.18微米，并且将采用铜配线技术，该技术可以极大地提高CPU的集成度和工作频率。

<<电脑组装和维护入门与提高>>

编辑推荐

《电脑组装和维护入门与提高(经典清华版)》结构清晰、语言简洁，是广大初级、中级电脑用户以及家庭电脑用户的首选工具书，适合于电脑使用者阅读，同时对于即将购买组装电脑的用户来说，也是最佳的学习和指导手册。

<<电脑组装和维护入门与提高>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>